Nel 2014 CPU saldate su schede madri?

di Paolo Franzese

La settimana scorsa alcuni rumor sul web hanno rivelato che nel 2014 Intel, la famosa casa produttrice di CPU, aveva in mente di allontanare la tecnologia socket LGA per implementare quella del package BGA cioè la saldatura delle CPU su schede madri anche per sistemi desktop.

L'adozione di questa nuova tecnologia anche per le versioni desktop avrebbe portato vantaggi in quanto i processori avrebbero un consumo minimo e le dimensioni sarebbero molto ridotte.

Ovviamente questo tipo di tecnologia "portatile" se così si può definire porterebbe sviluppare costi più elevati per i produttori e per i rivenditori perché eventuali CPU saldate su schede madri porterebbe un numero di schede madri veramente alto.

Ma Intel nei giorni scorsi ha in parte smentito questi rumor in una dichiarazione al sito Maximum PC; questo quanto dichiarato da Daniel Snyder, portavoce di intel:

Tutti i contenuti sono sotto Licenza Creative Commons
Contatti +39 388 1020417 - info@imaginepaolo.com

> “Intel remains committed to the growing desktop enthusiast and channel markets, and will continue to offer socketed parts in the LGA package for the foreseeable future for our customers and the Enthusiast DIY market. However, Intel cannot comment on specific long-term product roadmap plans at this time, but will disclose more details later per our normal communication process.”

Intel conferma l’intenzione di sviluppare una linea di prodotti basati sul package di tipo BGA senza tuttavia interrompere la produzione di soluzioni socket LGA e quindi di bloccare al gamma enthusiast.

Pericolo scampato stavolta per coloro che costruiscono e fanno upgrade ai propri computer desktop!

Da un articolo scritto da Paolo Franzese il 18 Dicembre 2012

Tutti i contenuti sono sotto Licenza Creative Commons
Contatti +39 388 1020417 - info@imaginepaolo.com